

2006年7月4日

報道関係各位

株式会社 構造計画研究所

構造計画研究所、高機能版樹脂流動解析ソフトの販売を開始

～ モールドフロージャパンと販売代理店契約を拡張 ～

株式会社 構造計画研究所（本社：東京都中野区、資本金 10 億 1,020 万円、社長：服部正太）は、高機能版樹脂流動解析ソフト「Moldflow Plastics Insight」の販売代理店契約を締結し、7月から国内で販売を開始します。

構造計画研究所は 1998 年から設計者向け樹脂流動解析ソフト「Moldflow Plastics Advisers」の国内一次代理店として金型業界における数多くの販売実績をあげてきました。しかし、お客様からは激しい価格競争や、海外との競合に打ち勝つために、より複雑な問題を解決できるソリューションを求めるニーズが増えております。その解決とマーケット深耕をねらいモールドフロージャパン社との契約内容を拡張し、高機能版樹脂流動解析ソフトの「Moldflow Plastics Insight」の販売代理店契約を締結するにいたしました。

モールドフロージャパン株式会社の鍛冶屋清二代表取締役は、今回の契約にあたり、「構造計画研究所が我々との戦略的パートナーシップを拡張されたことで、Moldflow Plastics Insight のマーケットへの浸透は更に加速すると確信しています。設計者向けCAEソフトを世に先駆けて販売・サポートされてきた構造解析研究所が築いた幅広い解析ノウハウと高い技術力はMoldflowユーザーへより多くの付加価値を提供することでしょう。」と述べています。

構造計画研究所としては、初年度 5000 万円、次年度は約 1 億円のビジネスへ展開していこうと考えています。

Moldflow Plastics Insight の概要

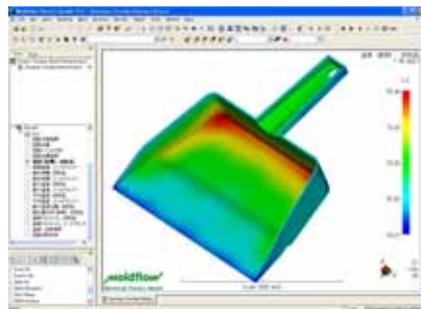
Moldflow Plastics Insight」は主に MPI/FLOW と呼ばれる熱可塑性樹脂の解析基本ソフトに、そのり収縮解析ができる MPI/WARP、金型冷却管解析ができる MPI/COOL、繊維配向解析ができる MPI/FIBER 等のオプションソフトを追加してシステムを構成します。

また、熱硬化性樹脂の解析基本ソフトとして MPI/Reactive、半導体封止解析に MPI/Microchip Encapsulation 等のオプションソフトを追加してシステムを構成します。

3次元 CAD で作成された形状モデルは MPI/Fusion、MPI/3D などのテクノロジーを用いてメッシュを切ります。

ソフトウェア 主な構成

- ・ MPI/FLOW 熱可塑性樹脂流動解析ソフト
- ・ MPI/Reactive 熱硬化性樹脂流動解析ソフト
- ・ MPI/COOL 金型冷却解析ソフト
- ・ MPI/WARP 収縮・反り変形解析ソフト
- ・ MPI/FIBER 繊維配向解析ソフト
- ・ MPI/GAS ガスアシスト成形解析ソフト
- ・ メッシュテクノロジー MPI/Fusion, MPI/3D, MPI/Midplane 等



Moldflow Plastics Insight Ver6.0

販売価格
お問合せ下さい。

モールドフロージャパンについて

モールドフロージャパン株式会社は、米国モールドフローコーポレーション（本社：ボストン、NASDAQ：MFLO）の全額出資会社で、設計から製造に至るまで、プラスチック射出成形特有の問題を効果的かつ機能的に解決する樹脂流動解析ソリューションを提供している。主に自動車、電機、電器、半導体、金型などの業界において、世界60ヶ国の約8,000社、国内では880社がMoldflow製品を活用している。

構造計画研究所について

1959年創立。現在、ネットワーク、マルチメディア、情報通信、移動体通信分野から建設、製造分野に至るまでの広範かつ最新のIT技術を駆使したソフトウェア開発ならびにソフトウェアプロダクトを提供。さらにOR・シミュレーション手法を用いた工学・製造分野におけるコンサルティングサービスやマーケティング分野におけるコンサルティングサービスも行う。また建設・環境分野における数値解析コンサルティングサービスや建築・構造設計分野でも強みを発揮しており、様々な業界に対し、多様なソリューションを提供している。

本リリースの内容に関するお問い合わせは下記へお願い致します。		
	本ニュースの詳細について	ニュースリリース配信元
担当者	株式会社構造計画研究所 SBD営業部 マーケティング担当 川村榮子	株式会社構造計画研究所 営業戦略部 佐藤仁宣、松本飛鳥
TEL	03-5342-1051(直)	03-5342-1032(直) 03-5342-1100(代)
FAX	03-5342-1055	03-5342-1222
e-mail	eiko@kke.co.jp	kkeinfo@kke.co.jp
住所	〒164-0011 東京都中野区中央4-5-3	〒164-0012 東京都中野区本町4-38-13
H.P.	http://www.sbd.jp/	http://www.kke.co.jp

構造計画研究所および、構造計画研究所のロゴは、株式会社構造計画研究所の登録商標です。その他の会社名及び製品名は、各社の商号、登録商標または商標です。